

# DS90UB9722-Q1 車載用 FPD-Link IV デュアルデシリアライザ ハブ、8MP+ カメラとその他のセンサ用 D-PHY CSI-2 出力ポート搭載

## 1 特長

- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
  - デバイス温度グレード 2: -40°C ~ 105°C
- デシリアライザは、最大 2 個のセンサからのデータを同時に集約
  - 7/8MP 以上のイメージヤに対応
  - 7.55Gbps のライン レート
  - シングルエンド同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブル
  - Power-over-Cable (PoC) に対応
- CSI v2.1 準拠のシステムインターフェイス
  - 最大 2 つの MIPI CSI-2 出力ポートをサポート
  - 16 個の仮想チャネルと VC-ID のリマッピング
- MIPI D-PHY v2.1 互換
  - ポートごとに 2 つのクロックで最大 4 つのデータレーン
  - レーンあたり最大 2.5Gbps、ポートあたり最大 10Gbps
- 2 個の CMLOUT 出力ポートで、ボード外部の処理に対応
  - 2 個の FPD RX ポートから複製された 2 個の CMLOUT ポート
  - 同じライン レートで別のデシリアライザを駆動可能
- センサ同期および診断用の 10 本の GPIO ピン
- デュアル I2C ポート
- 凍結フレームの検出
- レシーバの自動イコライゼーション
- DS90UB971-Q1, DS90UB981-Q1, DS90UB953-Q1, DS90UB953A-Q1, DS90UB951-Q1, DS90UB935-Q1, DS90UB933-Q1, DS90UB913A-Q1 シリアライザと互換
- GPIO 状態保持機能付き低電力スリープ モード

## 2 アプリケーション

- 車載用運転支援システム (ADAS)
- セキュリティと監視
- 産業用および民生用リモート カメラ
- 医療用画像処理システム

## 3 概要

DS90UB9722-Q1 は、FPD-Link デシリアライザで、堅牢な超高速の 7.55Gbps フォワード チャネルと 47.1875Mbps の双方向制御チャネルを搭載しており、最大 2 つの未加工データ センサを車載用同軸または STP ケーブルで中央処理装置に接続できます。DS90UB971-Q1 シリアライザと組み合わせることで、超高解像度 (8MP+/40fps) をサポートするイメージヤ、またはさまざまなトポロジの複数のセンサからビデオ データを受信できます。

受信されたデータは、ダウンストリーム プロセッサにインターフェイス接続するための、2 つの MIPI CSI-2 D-PHY の出力に集約されます。柔軟性ある MIPI CSI-2 出力は、ポートごとに複数の仮想チャネル インターリープをサポートしており、複数のセンサ、照射、データ タイプを区別します。この機能には、ビデオ集約モードと複製モードがあり、入出力ポートと仮想チャネル (VC-ID) のリマッピングをサポートしています。

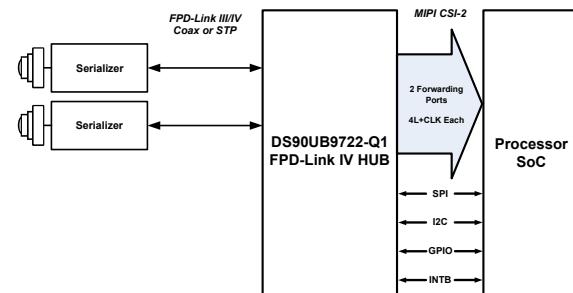
高度なデータ保護および診断機能により、システム全体の機能安全をサポートします。複数レベルのデータ整合性チェックおよび保護と、プログラム可能なヘルス ステータス割り込みにより、車両での堅牢なセンサ モジュールとリンク動作を確保できます。

### 製品情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージ サイズ (2)
DS90UB9722-Q1	VQFN (88)	12.00mm × 12.00mm

(1) 詳細については、[セクション 5](#) を参照してください。

(2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合にビンも含まれます。



代表的なアプリケーション回路図



このリソースの元の言語は英語です。翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール（機械翻訳）を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

## 4 Device and Documentation Support

### 4.1 Documentation Support

#### 4.1.1 Related Documentation

For related documentation see the following:

- Texas Instruments, [I<sup>2</sup>C Communication Over FPD-Link III with Bidirectional Control Channel](#), application note
- Texas Instruments, [I<sup>2</sup>C Bus Pullup Resistor Calculation](#), application note

### 4.2 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

### 4.3 Trademarks

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

### 4.4 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことをお勧めします。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

### 4.5 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

## 5 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

**PACKAGING INFORMATION**

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package   Pins	Package qty   Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
DS90UB9722TRURRQ1	Active	Production	VQFNP (RUR)   88	2500   LARGE T&R	Yes	NIPDAUAG	Level-3-260C-168 HR	-40 to 105	UB9722
DS90UB9722TRURRQ1.A	Active	Production	VQFNP (RUR)   88	2500   LARGE T&R	Yes	NIPDAUAG	Level-3-260C-168 HR	-40 to 105	UB9722
DS90UB9722TRURTQ1	Active	Production	VQFNP (RUR)   88	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAUAG	Level-3-260C-168 HR	-40 to 105	UB9722
DS90UB9722TRURTQ1.A	Active	Production	VQFNP (RUR)   88	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAUAG	Level-3-260C-168 HR	-40 to 105	UB9722

<sup>(1)</sup> **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

<sup>(2)</sup> **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

<sup>(3)</sup> **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

<sup>(4)</sup> **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

<sup>(5)</sup> **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

<sup>(6)</sup> **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

**Important Information and Disclaimer:** The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

## GENERIC PACKAGE VIEW

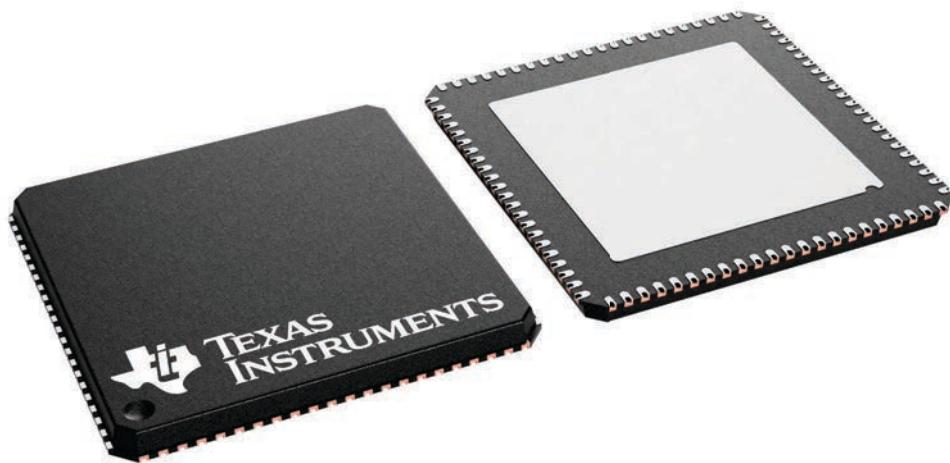
**RUR 88**

**VQFN - 0.9 mm max height**

**12 x 12, 0.5 mm pitch**

**PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD**

This image is a representation of the package family, actual package may vary.  
Refer to the product data sheet for package details.



4228969/A

## 重要なお知らせと免責事項

TIは、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の默示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または默示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したもので、(1)お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2)お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3)お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月